

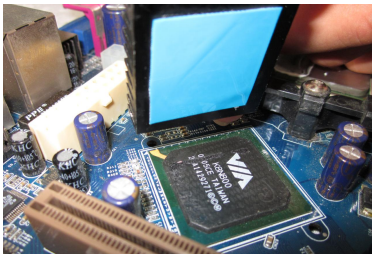
导热硅胶片 Thermal Pad

【产品概述 Product Description】

SF600G 导热硅胶片，用于填充两个物品的界面，使得界面的空气排出，提高导热效率。该产品有自粘性，可以模切成各种形状，容易装配。导热系数:6.0W/M.K。

SF600G thermal pad are used for filling the two contact surfaces. They are, so effectively exclude air from the contact interface. The products are naturally tacky, can be die-cut into various shapes, easy to operate. The thermal conductivity can reach 6.0w/m. k.

【产品图示 Product Illustration】



特性参数 SF600G		
颜色/Color	H 灰/H Grey	目视/Visual
厚度/Thickness	0.5- 5.0mm	ASTM D374
密度/Specific Gravity	3.30g/cm ³	ASTM D792
导热率/Thermal Conductivity	6.0 W/m. k	ASTM D5470
邵氏硬度 (Shore 00)	60-90°	ASTM D2240
伸长率/Elongation	20%	ASTM D412
拉伸强度/Tensile Strength	30psi	ASTM D412
抗电强度/Electrical Strength	>200VAC/mil	ASTM D149
UL 防火等级/UL Flammability Rating	UL94 V-0	***
体积电阻率/Volume Resistivity	1*10 ¹³ Ω . cm	ASTM D257
适用温度/Operating Temperature	-50 ~ 200°C	***
热阻/Thermal Resistance(1mm, @30psi)	0.29°C*in ² /W	ASTM D5470
压缩率/Compression Ratio(1mm, @30psi)	35%	***
介电常数/Dielectric Constant MHz	5.8	ASTM D150
RoHS	PASS	IEC 62321
Halogen	PASS	EN14582
REACH	PASS	EN14372

使用 ASTM D5470 测试器具, 记录值包括界面热阻, 数值仅供参考, 实际应用性能到所施加的表面粗糙度、平整度和压力。注: 厚度公差: ±10%, 硬度公差: ±5%。颜色/厚度/硬度均可按照客户需求测试。

【特点与优势/Features And Benefits】

- 较高的热导率 High thermal conductivity
- 阻燃性优异 Excellent flame retardant
- 电绝缘性能良 Good electrical insulation performance
- 柔韧性好、压缩率高 Good flexibility and high compression ratio

【产品规格 Configurations Available】

片状产品: 200*400mm 或依照顾客要求 模切产品: 依照顾客要求

【储存&运输】 贮存于通风、阴凉、干燥处，不要接触明火。本产品无毒，按非危险品贮存及运输

【包装】 根据客户需求定制包装

【有效期】 本产品有效期为 24 个月

【安全】 请参阅本公司《材料安全性能数据 (MSDS)》

以上这些建议及数据均来自我们认为可靠的资料。虽然是以诚信提供，但由于我们无法控制产品的使用条件和方法，无法对兼容性的应用提出任何建议，因此这些建议及数据仅供参考，而不作为产品保证。在任何时候，应由用户最终决定他们的生产线是否能够有效地使用。应由买方决定产品是否合适或适用特殊用途。不保证产品质量或适用性可满足任何特殊用途。我们建议潜在用户在大量使用前，首先确定我们的材料适用性和建议。

【典型应用/Applications】

- 半导体散热装置 Semiconductor heat sink
- 车载导航仪 Vehicle navigator
- 通讯&电源设备 Communication & power equipment
- 显卡、记忆存储模块 Graphics card, memory module
- LED 照明设备 LED lighting equipment
- LCD 和等离子电视 LCD and plasma TV

